|  |
| --- |
| **ALLEGATO A - DICHIARAZIONE REQUISITI MINIMI INDEROGABILI** |
| FORNITURA DI UN SISTEMA PER SPIN COATING, BAKING E SVILUPPO TRAMITE “RICHIESTA DI OFFERTA” (RDO) NELL’AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) |
| CIG 9259076F37 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA** | | | **CARATTERISTICHE DELL’ATTREZZATURA OFFERTA**  Indicare, **nella colonna evidenziata in verde**, i valori reali specifici delle caratteristiche dell’attrezzatura. Per i requisiti che non prevedono misure, confermare la presenza della caratteristica richiesta, ove possibile specificando modalità o dettagli dell’attrezzatura che rispondono al requisito. |
| **Tool** | **Caratteristica** | **Requisito minimo** |
| **Generale per spin coater+baking e sviluppatore** | **Garanzia di tutti i prodotti** | 12 mesi |  |
| Installazione e training | sì |  |
| **Tempi di consegna** | 18 settimane |  |
| Footprint massimo coater+baking | 1400x1000 mm |  |
| Footprint massimo sviluppatore | 1000x1000 mm |  |
| Massima taglia del wafer processabile | Maggiore o uguale a 8'' |  |
| Caricamento manuale del wafer | sì |  |
| Interfaccia utente con diversi livelli di accesso al software | sì |  |
| Funzioni start/stop rapide | sì |  |
| Chiusura di sicurezza delle camere di processo | sì |  |
| Aspirazione aree di processo per sicurezza operatore | sì |  |
|  |  |  |  |
| **Spin coater e sviluppatore** | Presenza arm per dispensing motorizzato con parametri di processo programmabili | sì |  |
| Possibilità di memorizzare programmi | sì |  |
| Numero di programmi/segmenti programmabili | Almeno 30 programmi da almeno 20 segmenti |  |
| Chucks portawafer compresi | 4'', 6'' e 8'' |  |
| Parametri di processo programmabili | sì |  |
| Materiale camera di processo | Resistente ai chimici |  |
|  | | | |
| **Spin coater** | **Numero di linee per fotoresist comprese** | 2 |  |
| **Massimo numero di linee per fotoresist installabili** | 4 |  |
| Numero linee azionate tramite motore | 1 |  |
| Numero linee azionate pneumaticamente | 1 |  |
| Possibilità dispensing manuale del PR | sì |  |
| Possibilità di futura installazione di linea per edg bead removal (EBR) | sì |  |
| Fissaggio wafer tramite vuoto | sì |  |
| Massima velocità di rotazione per wafer da 8'' | >=6000 rpm |  |
| Accuratezza della velocità di rotazione | migliore di 5% |  |
| Massima accelerazione/decelerazione | >=5000 rpm/s |  |
| Schermi protettivi usa e getta | sì |  |
| Tempo massimo di processo impostabile | >3600 s |  |
|  | | | |
| **Hot plate per baking** | Dimensioni hotplate | > 220x220 mm |  |
| Presenza di proximity pins removibili e con altezza controllabile | sì |  |
| Step di controllo altezza proximity pins | sì |  |
| Possibilità di priming con HMDS con ciclo di purge in azoto | sì |  |
| Possibilità di chiudere il coperchio durante il bake | sì |  |
| Possibilità di programmare rampe di temperatura | sì |  |
| Numero segmenti per singolo programma | >10 |  |
| Limitatore di temperatura automatico per evitare surriscaldamento | sì |  |
| Temperatura massima | > 200°C |  |
| **Accuratezza del valore di temperatura** | +/- 1°C a 100°C |  |
| Possibilità di livellare la piastra | sì |  |
|  | | | |
| **Sviluppatore** | **Numero linee per dispensing del developer comprese** | 1 |  |
| **Numero massimo linee per dispensing del developer installabili** | 2 |  |
| Erogatore per acqua deionizzata e azoto montato sul braccio | sì |  |
| Massima velocità di rotazione | > 2000 rpm |  |
| Massima accelerazione | > 5000 rpm |  |
| Velocità massima del braccio | > 150 mm/s |  |
| Tempo massimo di processo | > 2000 s |  |